



Soldadura en Pasta XGSP40-35G MECHANIC

Descripción

CARACTERÍSTICAS

Aplíquese con pincel, directo al dispositivo en reparación.

Evita la oxidación de las pistas de cobre en circuitos impresos y permite obtener soldaduras brillantes y confiables.

No sobrecalentar, se puede destruir el flux y el cobre perdería sus propiedades mecánicas.

Ideal para microelectrónica con soldaduras sin plomo.

Debe utilizarse en equipos apagados.

VENTAJAS

Reduce el óxido en los componente y superficies aplicadas.

Reduce la tensión superficial de la soldadura fundida.

Ayuda a prevenir la oxidación de la superficie durante y después de la soldadura.

Mejora la transferencia de calor entre la superficie a soldar, obteniendo así una mejor calidad den el trabajo.

ESPECIFICACIONES

MODELO	XGSP40-35G
MARCA	MECHANIC
TIPO	Pasta para Soldar
CONTENIDO	35 gramos
PUNTO DE FUSIÓN	138°C

CONTENEDOR Frasco de plástico

WESTOR.PE